深圳丹邦科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Shenzhen Danbond Technology Co.,Ltd.

（注册地址：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼）

保荐机构（主承销商） 国信证券股份有限公司

（注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

一、本次发行前公司总股本12,000万股，本次拟发行4,000万股流通股，发行后总股本为16,000万股，16,000万股均为流通股。

公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍及公司股东深圳市丹依科技有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

公司股东益关寿、深圳市信瑞鸿网络科技有限公司、深圳市华浩投资有限公司及深圳市百顺投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

除此之外，公司董事及高级管理人员刘萍、王李鹗，监事邹盛和及核心技术人员刘文魁还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接及间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接及间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人直接及间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。

二、根据公司2010年9月15日通过的2010年第二次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由本次公开发行股票后的新老股东按持股比例共享。截至2010年12月31日，母公司未分配利润为8,981.52万元。

三、2007年5月，控股股东丹依发展以“UV固化可剥离压敏胶膜”、“一种无腐刻蚀液”、“一种潜伏性固化剂的制造方法”及“用于芯片搭载及封装的电绝缘树脂浆”四项发明专利对丹邦有限出资。根据深圳中联岳华会计师事务所出具的深中岳评报字（2007）第007号资产评估报告书，四项发明专利于评估基准日2006年12月31日的评估值为4,843万元，经2007年1月28日丹邦有限董事会决议同意，丹依发展以上述无形资产的评估值为参考作价4,623万元出资至丹邦有限，占此次增资完成后公司注册资本的46.23%。

四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

（一）所得税优惠被追缴的风险

2007年5月，公司外资股权比例从25%变更为12.67%，成为“外资比例低于25%”的外商投资企业。根据国家税务总局有关规定，公司于2007年5月外资比例低于25%之后应补缴已免征、减征的企业所得税税款。

但根据深圳市地方法规的相关规定，公司作为在深圳经济特区内设立的生产性企业，可享受按优惠税率及减半征收企业所得税的税收优惠政策。公司2006年为开始获利年度，据此2006年度至2007年度可免征企业所得税，2008年度至2010年度减半征收企业所得税。深圳市南山区地方税务局于2011年1月24日出具确认函确认发行人无需补缴2006年1月1日起至2010年12月31日期间已免征、减征的企业所得税税款。但若该具体行政行为被国家有权机关作出撤销的决定或人民法院作出撤销或认定无效的判决，则发行人2006年1月1日起至2010年12月31日期间已免征、减征的企业所得税税款可能存在被追缴的风险。

（二）资产抵押风险

截至2011年6月30日，公司将主要生产用房屋建筑物、机器设备、发明专利等资产为公司的银行借款提供抵押或质押担保。根据抵押合同及质押合同的约定，如果公司不能按合同约定足额偿还银行贷款本息，亦不能通过协商解决，上述公司资产将被依法拍卖、变卖或折价等方式处分。因此公司存在因不能按时偿还银行贷款而丧失对该房屋建筑物、机器设备及专利技术的所有权，进而影响正常生产经营的风险。

第二节 本次发行概况

1、股票种类	人民币普通股（A股）
2、每股面值	1.00元
3、发行股数	4,000万股，占发行后总股本的25%
4、每股发行价格	通过向询价对象初步询价，由发行人和主承销商根据初步询价情况直接确定发行价格
5、市盈率	[ ]倍（每股收益按照2010年12月31日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
6、发行前每股净资产	2.36元（按照2010年12月31日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）
7、发行后每股净资产	[ ]元（按照2010年12月31日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
8、发行方式	采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
9、发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
10、预计募集资金总额	约[ ]亿元
11、预计募集资金净额	约[ ]亿元
12、承销方式	主承销商余额包销
13、发行费用概算	承销及保荐费用 [ ]万元
	律师费用 [ ]万元
	审计费用 [ ]万元
	发行手续费用 [ ]万元

注：本招股意向书摘要中的简称与招股意向书中的简称具有相同含义。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

1、中文名称：深圳丹邦科技股份有限公司

2、英文名称：Shenzhen Danbond Technology Co.,Ltd.

3、注册资本：12,000万元

4、法定代表人：刘萍

5、成立日期：2001年11月20日

6、股份公司设立日期：2009年6月5日

7、公司住所：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼

8、邮政编码：518052

9、联系电话：0755-26511518

10、传真号码：0755-26981718

11、互联网地址：http://www.danbang.com/

12、电子信箱：szdbond@danbang.com

二、发行人的历史沿革和改制重组情况

（一）发行人设立方式及发起人

本公司系由丹邦有限整体变更设立的股份有限公司。2009年2月23日，丹邦有限股东丹邦投资、丹依科技、益关寿、信瑞鸿网络、华浩投资、百顺投资作为发起人签订《发起人协议》，同意丹邦有限整体变更设立为股份有限公司。2009年6月5日，丹邦科技在深圳市工商行政管理局登记注册成立。

（二）发起人投入的资产内容

发行人由丹邦有限整体变更设立，继承了丹邦有限的全部资产、负债和权益。根据开元信德会计师出具的深审字（2009）第148号《审计报告》，丹邦有限截至2008年12月31日所拥有的主要资产为：流动资产17,337.14万元，其中存货为998.44万元；非流动资产为31,719.08万元，其中固定资产为27,179.16万元、无形资产为4,148.44万元。

发行人成立时继承了丹邦有限的全部业务：从事FPC、COF柔性封装基板及COF产品的研发、生产和销售。

三、有关股本的情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通和锁定安排

公司本次发行前总股本12,000万股，本次拟公开发行4,000万股，公司发行前后股本变动情况如下：

单位：万股

类别	股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构	
		持股数	持股比例	持股数	持股比例
有限售条件的股份	丹邦投资集团	7,311.60	60.93%	7,311.60	45.70%
	丹依科技	2,160.00	18.00%	2,160.00	13.50%
	益关寿	1,520.40	12.67%	1,520.40	9.50%
	信瑞鸿网络	480.00	4.00%	480.00	3.00%
	华浩投资	480.00	4.00%	480.00	3.00%
	百顺投资	48.00	0.40%	48.00	0.30%
	有限售条件的股份小计	12,000.00	100.00%	12,000.00	75.00%
本次发行的股份		-	-	4,000.00	25.00%
总 计		12,000.00	100.00%	16,000.00	100.00%

本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺情况参见第一节“重大事项提示”。

（二）前十名股东、前十名自然人股东持股情况

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例	是否发起人	股权性质
1	丹邦投资集团	7,311.60	60.93%	是	法人股
2	丹依科技	2,160.00	18.00%	是	法人股
3	益关寿	1,520.40	12.67%	是	自然人股
4	信瑞鸿网络	480.00	4.00%	是	法人股
5	华浩投资	480.00	4.00%	是	法人股
6	百顺投资	48.00	0.40%	是	法人股
合 计		12,000.00	100.00%	-	-

（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前，实际控制人刘萍通过丹邦投资集团间接持有公司60.93%的股份，刘萍的侄子刘文魁通过丹依科技间接持有公司9%的股份。

除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

四、发行人的主营业务情况

（一）主营业务及主要产品

本公司自成立以来专注于FPC、COF柔性封装基板及COF产品的研发、生产与销售，致力于在微电子领域为客户提供全面的柔性互连解决方案及基于柔性基板技术的芯片封装方案。

1、FPC简介

FPC是柔性印制电路板，是连接电子零件用的基板和电子产品信号传输的媒介，作为印制电路板的一种重要类别，广泛应用于手机、笔记本电脑、液晶显示器、等离子显示器、数码相机以及硬盘、光驱、PC配件等消费电子产品，2009年全球FPC产值占全球印制电路板总产值的16.1%。

2、COF柔性封装基板简介

COF柔性封装基板作为印制电路板产品中的重要高端分支产品，指还未装联上芯片、元器件的封装型柔性基板。在芯片封装过程中，起到承载芯片、电路连通、绝缘支撑的作用，特别是对芯片起到物理保护、提高信号传输速率、信号保真、阻抗匹配、应力缓和、散热防潮的作用。

3、COF产品简介

COF产品是用COF柔性封装基板作载体，将半导体芯片直接封装在柔性基板上形成的芯片封装产品。COF产品的作用是通过柔性基板与液晶面板连接导通芯片，由芯片驱动和控制液晶面板电流、电压从而改变液晶状态显示不同画面。COF产品广泛应用于液晶电视、智能3G手机及笔记本电脑等产品液晶屏的显示驱动。

（二）产品销售方式和渠道

公司产品以出口为主，报告期内产品外销比例均保持在98%以上，产品销售市场主要集中于日本、欧美、东南亚（包括韩国）、香港等国家和地区。公司境外销售分为三种情况：直接出口、转厂出口、通过丹邦香港（2009年8月以前为第比尔国际）代理出口。公司国内销售主要采取向客户直接销售的内销模式。

（三）所需主要原材料

公司生产所需原材料品种较多，主要包括铜箔、PI膜、保强板、粘合剂、芯片及器件等，其中PI膜大部分由境外进口，保强板、粘合剂、芯片及器件大部分由境内采购，铜箔境内、境外采购数量相当。公司在境外及境内均具有良好的采购和配套渠道，在多年的经营中，公司已与多家原材料生产厂商建立了长期稳固的合作关系，且每种主要原材料供应商数量保持两家以上，原材料来源和质量有保证。与此同时，珠三角地区电子元器件生产供应厂商众多，元器件供应充足。

公司生产所需能源主要为水和电力，由深圳供水、供电系统供应，报告期内供应稳定。

（四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

1、市场竞争概况

FPC产品市场集中度较低，呈现高度分散的竞争格局，中国大陆目前有100多家FPC生产企业；COF柔性封装基板全球市场份额长期被日本、韩国领先企业高度垄断。2009年，销售额排名前七位的企业占全世界销售额的97%，呈现高度集中的竞争格局。本公司主导产品在全球和中国的主要竞争对手情况如下：

序号	产品类别	主要竞争对手	
		全球主要竞争对手	中国主要竞争对手
1	FPC	NOK、Multek、Hitachi Chemical	珠海紫翔电子、安捷利电子、珠海元盛电子
2	COF柔性封装基板、COF产品	日立电线、三井金属矿业、LG Micron、STEMCO	索尼凯美高

2、发行人在行业中的竞争优势及地位

①领先的技术优势

经过多年的技术攻关和生产实践，公司成功掌握具有国际先进水平的三项核心技术：高性能薄膜成型技术、高密度微细线路制造技术及基于柔性基板的芯片封装技术，并运用上述技术实现了高端2L-FCCL、COF柔性封装基板及COF产品的产业化，填补了我国在高端柔性覆铜板材料及柔性封装基板领域的技术空白，打破了日本、韩国等国家和地区企业对关键材料的技术垄断。

公司的技术水平在国内同行中处于领先地位，部分技术接近国际尖端水平。公司承担的“高性能特种挠性电路连接与封装技术”项目是为了满足国家航天、航空、舰艇、兵器等军事电子装备的应用需求，为我军武器装备的发展和进步提供技术支撑。公司的技术研发项目如线宽线距20μm的超微细化线COF柔性封装基板和厚度小于10μm的高端2L-FCCL基膜是根据国际上最新的技术发展方向所做的前瞻性研究，符合电子信息产品轻薄短小的发展趋势，是公司在未来几年内持续保持技术领先的保证。

公司目前已获得发明专利9项，并且公司有多项产品和科技成果荣获国家级或省级新产品奖以及科技成果奖，其中：COF封装基板在2010年被国家科技部认定为“国家重点新产品”；先进COF超微线路及封装产业化项目被深圳市政府评为2006年度“深圳市科技创新奖”，并被广东省政府评为2007年度“广东省科学技术三等奖”。

2009年1月，公司作为项目联合单位开始承担国家科技重大专项（02专项）“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”项目下属的“芯片柔性封装基板技术与中试工艺开发”课题研究任务。2011年2月，公司子公司广东丹邦作为项目责任单位获批承担国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”项目下属的“三维柔性基板及工艺技术研发与产业化”项目。国家科技重大专项是为了实现国家目标，通过核心技术突破和资源集成，在一定时限内完成的重大战略产品、关键共性技术和重大工程。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》确定了大型飞机、极大规模集成电路制造装备与成套工艺等16个重大专项，这些重大专项是我国到2020年科技发展的重中之重。

②完整的全产业链布局

公司专注于微电子柔性互连与封装业务，形成了从FCCL→FPC、FCCL→COF柔性封装基板→COF产品的完整产业链，是全球极少数产业链涵盖从基材、基板到芯片封装的企业之一。

FCCL是生产FPC及COF柔性封装基板的主要原材料，占整个产品成本的40%-50%左右，但国内能够生产高档FCCL的企业非常少，特别是高端2L-FCCL基本靠进口。本公司打破日本、韩国等国对高端FCCL的技术垄断，实现了上游关键原材料柔性封装基板用高端2L-FCCL、FPC用3L-FCCL和普通2L-FCCL的自产，使得公司产品具有明显成本优势，增强了产品的市场竞争力，提升了公司的行业地位。同时，由于公司实现了上游关键原材料的自产，并严格控制产业链各个中间产品的质量，确保工艺流程的顺畅，使得公司产品能够长期保持稳定的质量水平，产品质量的稳定有利于公司形成稳定的客户关系。

③优质的客户资源

公司先进的技术水平、稳定的产品质量和可靠的产品性能在下游客户中赢得了良好的声誉并获得客户的广泛认可，目前，公司与多家世界500强企业及全球知名的电子信息产品品牌制造商建立了持久稳定的客户关系，已成为日本电产、夏普、佳能、日立、JVC、三洋电机等全球知名的电子信息产品品牌制造商的高端柔性电路板、COF柔性封装基板及COF产品的重要供应商之一，产品远销亚洲、欧洲、美洲等20多个国家和地区，在FPC、COF柔性封装基板及COF封装领域形成了较高的知名度和良好的信誉度。

本公司的COF柔性封装基板及COF产品主要用于上述国际顶尖电子信息产品制造商的高端产品（比如本公司销售给佳能（Canon）影像器材用的COF柔性封装基板及COF产品均是用于1,000万像素以上的照相机）。在与国际顶尖电子信息产品生产商的合作过程中，公司能够汲取最新的国际生产经营理念，把握行业动态和技术走向，为进一步开拓市场创造有利条件。

④突出的行业地位

本公司坚持实施高端产品竞争战略，通过多年的技术创新和市场开拓，市场竞争能力不断增强，已经形成较为完整的产业链和合理的产品结构，是全球极少数产业链涵盖从基材、基板到芯片封装的企业之一。

公司2008年、2009年连续两年成为中国最大的COF柔性封装基板生产商，全球市场占有率分别为1.1%、1.55%，全球市场占有率稳步提高，2009年成为全球第八大COF柔性封装基板生产商。

公司是国家级高新技术企业，是国家科技部认定的“国家高技术研究发展计划成果产业化基地”，拥有“国家挠性电路与材料研发中心”。2009年1月、2011年2月，公司及子公司广东丹邦先后获批承担国家科技重大专项（02专项）的课题研究任务及项目，国家科技重大专项是国家支持行业发展的具体举措，承担国家科技重大专项是国家对本公司技术研发水平、行业领先地位的肯定，对于公司产品档次升级和提升公司核心竞争力具有非常重要的意义。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

截至本招股意向书摘要签署之日，公司持有12项国内注册商标，取得9项发明专利。

本公司及控股子公司目前共拥有2宗土地使用权，1宗位于广东省深圳市南山区、1宗位于广东省东莞市松山湖，上述地块已经建设工业厂房及配套房产，或用作公司员工宿舍。

公司的主要设备主要从日本、美国进口，包括LCP净化涂布机装置、微电子涂布机、特殊雾围R-R热处理工程装置、电磁加热覆合机等设备，主要设备达到国际先进水平。

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争情况

本公司控股股东丹邦投资集团无实际的生产经营业务，目前主营业务为投资兴办实业，除投资本公司外，还持有第比尔国际、典邦科技及广东东邦的股权，因此丹邦投资集团与本公司不存在同业竞争关系。

本公司的实际控制人为刘萍，除投资丹邦投资集团及其下属企业外，无其他实际控制企业，没有自营或者为他人经营与本公司同类的业务，故刘萍先生与本公司不存在同业竞争。

典邦科技主要从事液晶显示模组的代工业务，即根据客户的委托，由客户提供加工液晶显示模组所需的样品、原材料及有关技术资料，代为生产加工液晶显示模组产品，并收取一定代工费。典邦科技和本公司的主营业务与产品分属不同领域，主要体现在以下几个方面：①产品属于不同行业；②产品物理构成及特征明显不同；③产品功能用途存在本质差异且不具有类似性及相互替代的可能性；④在下游应用及客户方面不存在相互竞争关系。综上所述，典邦科技未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。

广东东邦尚未开展生产与销售活动，成立后主要从事建设实施本次募投项目所需的生产厂房、研发大楼及生活配套设施等活动，广东东邦经营范围主要从事液晶显示器件的生产与销售业务，不会从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。

第比尔国际曾是本公司境外销售和采购的重要窗口公司，主要职能就是满足部分客户及供应商的要求、充分利用香港商业发达的贸易环境、集中境外客户资源和外资银行资源、办理银行结算手续、代收客户货款、代付供应商采购款、协助报关等。截至2009年8月，公司通过第比尔国际的境外销售及采购合同（订单）全部履行完毕，境外采购或销售不再通过第比尔国际进行。此后，第比尔国际仅作为一家境外投资主体而存在，与本公司不存在同业竞争。

（二）主要关联交易情况

1、通过关联方进行部分境外销售和采购

2009年8月之前，公司部分境外销售及境外原材料、设备采购在形式上经由实际控制人刘萍在香港设立的第比尔国际进行，具体情况如下：

①销售商品

单位：万元

项 目	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
向第比尔国际销售商品的金额	-	-	404.64	5,842.88
主营业务收入	-	-	18,254.82	17,139.84
关联交易占主营业务收入比重	-	-	2.22%	34.09%

产生上述关联销售的原因是本公司在2008-2009年部分境外销售通过第比尔国际进行。自2008年5月起，本公司全资子公司丹邦香港开始承接原来通过第比尔国际进行的境外销售的职能。2009年，本公司通过第比尔国际的关联销售金额和占比均大幅度降低，2010年已不再发生该类关联交易。

②采购原材料、设备

单位：万元

关联采购	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
向第比尔采购原材料的金额	-	-	965.82	2,560.90
向第比尔采购设备的金额	-	-	3,170.05	3,674.95
向第比尔采购商品的总金额	-	-	4,135.87	6,235.85
公司采购总额	-	-	12,705.48	8,737.53
关联采购占公司采购的比重	-	-	32.55%	71.37%

产生上述关联采购的原因是本公司在2008-2009年部分境外设备与原材料采购通过第比尔国际进行，本公司向第比尔国际采购商品的价格与第比尔国际向境外供应商采购商品的价格相一致。

自2008年5月起，本公司全资子公司丹邦香港开始承接原来通过第比尔国际进行的境外采购职能。因此，2009年，本公司通过第比尔国际的关联采购金额和占比均大幅度降低，2010年已不再发生该类关联交易。

2、向关联方转让设备

2008年7月18日，丹邦有限向典邦科技出售一批设备，转让价格以评估值参考确定为7,940,472.11元。典邦科技已于设备移交前支付完毕上述设备转让价款。该批设备系一批用于异方导电膜的研发设备，根据公司业务发展规划，公司专注于FPC、COF柔性封装基板等产品的研发与生产，于是将该批设备出售给典邦科技。

3、收购土地使用权、地上建筑物及附着物

2010年9月13日，本公司子公司广东丹邦与实际控制人控制的广东东邦签署了《资产收购协议书》。根据该《资产收购协议书》，广东丹邦拟收购广东东邦位东莞市松山湖科技产业园区北部工业城C区，土地面积为56,964平方米的土地使用权（宗地号为1935030100045）及其地上建筑物、附着物用于实施募集资金投资项目。

2011年4月15日，广东丹邦与广东东邦签署《补充协议》，广东丹邦以审计账面值为参考作价63,482,104.02元购买广东东邦拥有的上述土地使用权和在建工程。广东丹邦已向广东东邦支付全部转让价款，2011年5月9日，广东丹邦取得东莞市人民政府颁发的1935030100045号宗地的《国有土地使用证》（东府国用（2009）第特66号）。

（三）关联交易对经营状况和财务状况的影响

本公司具有独立的采购、生产、销售系统，在销售及采购环节发生的关联交易均为公司经营所必需，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

（四）公司独立董事关于近三年及一期重大关联交易事项的意见

本公司独立董事已对本公司报告期的关联交易协议及其履行情况进行审核，并发表意见如下：“公司最近三及一期年内所发生的关联交易已依法履行相关决策程序，遵循平等、自愿原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易，不存在损害发行人和非关联股东利益的情形。”

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员职务及简要经历

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历
刘 萍	董事长、总经理、研发中心主任	男	46岁	2009年5月至2012年5月	历任深圳市新追求公司部门经理，典邦柔性、丹邦柔性总经理。现任本公司董事长、总经理及研发中心主任，兼任丹邦投资集团、典邦科技、广东东邦、广东丹邦董事长，丹邦香港、第比尔国际董事。
王李鹗	董事、副总经理	男	44岁	2009年5月至2012年5月	历任湖北省政府发展研究中心科员、深圳市新追求公司副总经理、总经理。现任本公司董事、副总经理，兼任丹邦投资集团董事，广东丹邦董事、总经理，丹依科技、广东东邦副董事长，典邦科技监事。
益天鹏	董事	男	36岁	2009年5月至2012年5月	曾任第比尔国际营业经理。现任本公司董事、兼任丹邦香港总经理。
龚 艳	独立董事	女	43岁	2009年5月至2012年5月	历任中南大学计财处教学经费主管会计、机械学院主管会计、计财处科研财务科科长、计财处会计二科长，现任湖南中大业翔科技有限公司财务总监、本公司独立董事。
赖延清	独立董事	男	37岁	2009年5月至2012年5月	曾任中南大学冶金科学与工程学院讲师、副教授，现任中南大学冶金科学与工程学院教授、中南大学轻金属及工业电化学研究所副所长、本公司独立董事。
邹盛和	监事会主席	男	45岁	2009年5月至2012年5月	曾任典邦柔性财务部长。现任本公司监事会主席，兼任广东丹邦副董事长，丹邦投资集团、典邦科技、丹依科技、广东东邦董事。
殷 鹰	监事、技术研发部部长	男	34岁	2009年5月至2012年5月	曾任深圳中络电子有限公司部门主管。现任本公司监事、技术研发部部长。
刘绪芳	监事、资材部课长	女	35岁	2009年5月至2012年5月	曾任德昌电机（深圳）有限公司生产材料控制科主管、晶浩达电子有限公司生产材料控制科主管、东莞新科影音制品厂生产材料控制科主管。现任本公司监事、资材部课长。
唐苗丽	财务负责人	女	29岁	2009年6月至2012年5月	曾任深圳合悦嘉贸易有限公司会计、深圳深信会计师事务所审计员、深圳天健信德会计师事务所项目经理、典邦科技财务主管。现任本公司财务负责人。
吴 荔	董事会秘书	女	33岁	2010年4月至2012年5月	曾任东莞宏远工业区股份有限公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

（二）董事、监事、高级管理人员兼职、薪酬及持股情况

姓名	本公司职务	2010年含税薪酬情况（万元/年）	持有本公司股份数量（万股）	兼职单位	在兼职单位的职务	兼职单位与公司关系
刘 萍	董事长、总经理、研发中心主任	19.80	7,311.60	丹邦投资集团	董事长	控股股东
				丹邦香港	董事	公司子公司
				广东丹邦	董事长	公司子公司
				典邦科技	董事长	关联公司
				广东东邦	董事长	关联公司
				第比尔国际	董事	关联公司
王李鹗	董事、副总经理	17.52	540.00	丹邦投资集团	董事	控股股东
				丹依科技	副董事长	公司股东
				广东丹邦	董事、总经理	公司子公司
				广东东邦	副董事长	关联公司
				典邦科技	监事	关联公司
益天鹏	董事	-	-	丹邦香港	总经理	公司子公司
龚 艳	独立董事	5.00	-	湖南中大业翔科技有限公司	财务总监	无关联关系
赖延清	独立董事	5.00	-	中南大学冶金科学与工程学院	教授	无关联关系
				中南大学轻金属及工业电化学研究所	副所长	无关联关系
邹盛和	监事会主席	18.12	540.00	丹邦投资集团	董事	控股股东
				丹依科技	董事	公司股东
				广东丹邦	副董事长	公司子公司
				典邦科技	董事	关联公司
				广东东邦	董事	关联公司
殷 鹰	监事、技术研发部部长	9.04	-	-	-	-
刘绪芳	监事、资材部课长	6.30	-	-	-	-
唐苗丽	财务负责人	16.20	-	-	-	-
吴 荔	董事会秘书	13.60	-	-	-	-

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

（一）控股股东

本公司的控股股东为丹邦投资集团，丹邦投资集团现持有本公司股份7,311.60万股，占本公司发行前股份的60.93%。丹邦投资集团成立于2001年6月21日，法定代表人为刘萍，注册资本与实收资本均为9,000万元，目前的主要业务为持有本公司的股权，未开展其他业务。

（二）实际控制人

刘萍持有发行人控股股东丹邦投资集团100%的股权，具有绝对控股权，是发行人的实际控制人。发行人自设立以来实际控制人未曾发生变化。刘萍的基本情况如下：

刘萍，中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码：42232719651022****，住所：广东省深圳市福田区国企大厦永裕楼。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）近三年及一期经审计的财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

资产	2011年6月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：				
货币资金	2,676.77	2,050.44	4,974.78	3,949.32
应收账款	5,421.10	4,592.96	5,589.65	6,521.74
预付款项	6,799.50	4,507.55	139.06	5,426.55
其他应收款	1,211.48	439.34	283.89	129.15
存货	1,712.44	1,603.33	2,276.99	998.44
流动资产合计	17,821.29	13,193.63	13,264.37	17,025.20
非流动资产：				
固定资产	32,755.46	34,110.28	31,034.46	26,992.52
在建工程	11,643.39	-	1,822.38	402.79
工程物资	7.33	3,803.32	17.17	1.18
无形资产	8,679.55	4,452.01	3,837.09	4,138.22
开发支出	370.95	800.29	752.19	-
递延所得税资产	117.19	109.78	90.15	85.52
非流动资产合计	53,573.87	43,275.69	37,553.44	31,620.23
资产总计	71,395.15	56,469.32	50,817.81	48,645.42

2、合并资产负债表（续）

（下转A8版）

深圳丹邦科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

特别提示

深圳丹邦科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。

重要提示

1、深圳丹邦科技股份有限公司（下称“丹邦科技”或“发行人”）首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1373号文核准。丹邦科技的股票代码为002618，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下发行不超过800万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量，为3,200万股。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（下称“国信证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。

3、国信证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2011年8月31日（T-5日）至2011年9月2日（T-3日）期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。符合要求的询价对象及配售对象可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。

4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记备案的机构，包括国信证券自主推荐、已向协会备案的20名询价对象。

5、上述询价对象于初步询价截止日2011年9月2日（T-3日）12:00前在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参与本次网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象，未参与初步询价或者参与初步询价但有效报价低于发行价格的配售对象不得参与网下申购。

6、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格。配售对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及国信证券研究所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为160万股，即配售对象的每档申购数量必须是160万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过800万股。

8、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。

9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证监会和协会备案。

10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（160万股）配号的方法，国信证券将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终将摇出5个号码，每个号码可获160万股股票。

若网下有效申购总量等于800万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

11、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

12、发行人及主承销商将于2011年9月9日（T+2日）在《深圳丹邦科技股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中公布配售对象的报价情况。

13、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：

①初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20家；

②网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量800万股；

③网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量3,200万股，向网下回拨后仍然申购不足；

④发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。

14、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

15、本公告仅对本次